

2013 年机械结构与智能材料国际会议(ICMSSM 2013)

2013 年 11 月 15 日-16 日 中国·厦门

<http://www.icmssm.org/>

◆ 会议简介

2013 年机械结构与智能材料国际会议(ICMSSM 2013)将于 2013 年 11 月 15 日—16 日在中国美丽的城市海上花园——厦门召开。

作为 TTP 官方列表的正式会议，ICMSSM 经同行专家评审录用的论文将全部出版在《Applied Mechanics and Materials》[ISSN:1660-9336, Trans Tech Publications]上，目前，该刊物上发表的论文全部被 EI Compendex 和 ISTP 收录。

查询该刊物检索情况请访问刊物官方网站：<http://www.ttp.net/1660-9336.html>

◆ 会议征文

会议内容涵盖了机械结构与智能材料领域的主要研究方向，旨在为全世界机械结构与智能材料领域的专家、学者和专业技术人员提供一个交流最新研究成果的机会。热忱欢迎从事相关技术研究的专家、学者和专业技术人员踊跃投稿并参加大会。会议主题包括机械结构和机械工程、机电工程、机械制造技术、电子学和自动化、材料科学与工程、智能材料、材料制造和加工等。

◆ 投稿方式

1. 会议论文投稿

(1) Easychair 投稿，投稿地址：<http://www.easychair.org/conferences/?conf=icmssm2013>

(2) email: cfp@icmssm.org 投稿

投稿相关事宜详见：<http://www.icmssm.org/submission.htm>

◆ 重要日期

论文截稿时间：2013年10月9日
录用通知日期：2013年10月16日
注册截止日期：2013年10月23日
大会召开日期：2013年11月15日-16日

◆ 联系方式

Email：cfp@icmssm.org

网址：<http://www.icmssm.org/>

电话：纪老师024-83958169-801

林老师024-83958379-811

QQ：2947191913

